

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2026-020

# 广州广合科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.46 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	广合科技	股票代码	001389（A 股）、01989（H 股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曾杨清	陈炜亮、黄淑芳	
办公地址	广州保税区保盈南路 22 号	广州保税区保盈南路 22 号	
传真	020-82210929	020-82210929	
电话	020-82211188-2885	020-82211188-2885	
电子信箱	stock@delton.com.cn	stock@delton.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

广合科技成立于 2002 年 6 月，公司主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售，报告期内公司主营业务没有发生变化。公司印制电路板产品主要定位于中高端应用市场，在产品精度、密度和可靠性等方面具有较高要求，产品广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域，其中服务器用 PCB 产品的收入占比约八成，是公司产品最主要的下游应用领域，产品应用于高性能计算服务器、AI 运算服务器、存储服务器、交换机等数据中心的核心设备，为全球大数据、云计算等产业提供重要电子元器件供应。

公司是国家高新技术企业，多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速 PCB 领域的研究。公司拥有多项应用于各类服务器 PCB 板的核心技术，形成了自主知识产权，并掌握了与之配套的高精度制造工艺。公司“服务器主板用印制电路板”入选国家工业和信息化部办公厅、中国工业联合会组织开展的 2022 年第七批国家级“制造业单项冠军产品”，公司“AI 服务器超高阶高多层复合基板项目”获得中国电子学会 2025 年科技进步奖三等奖，“超小台阶阶梯金手指 PCB 关键技术的研发及应用”项目荣获 2025 年度广东省电子学会科技进步奖二等奖，“用于高性能计算(HPC)的大 BGA 服务器主板”获 2025 年广东省高新技术协会科技进步奖二等奖。

此外，公司“高端服务器用高性能印制电路板”、“用于高性能计算(HPC)的大 BGA 服务器主板”、“AI 服务器超高阶高多层复合基板”等多项核心技术相关的产品被认定为 2025 年广东省名优高新技术产品。

## （二）报告期内公司所处行业情况

公司所处行业属于电子元器件及电子专用材料制造行业。印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），其主要功能是使各种电子元器件组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。PCB 产业在世界范围内广泛分布，中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国、欧洲、东南亚是全球 PCB 主要的生产基地。PCB 作为电子终端设备不可或缺的组件，印制电路板产业的发展水平在一定程度上体现了国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水平。作为电子信息产业重要的配套，PCB 行业的发展与下游需求密切相关，下游行业的应用需求对 PCB 的精密度和稳定性都提出更高的要求，推动 PCB 行业向高密度化、高性能化方向发展。另外，PCB 行业作为电子信息产业上游的元器件行业，受宏观经济以及国际政经关系影响较大。

据 Prismark2025 年第四季度报告预测，2025 年全球 PCB 产业以美元计价的产值将达到 848.91 亿美元，同比增加 15.4%，预计到 2029 年，全球 PCB 市场规模将突破 1000 亿美元大关。随着全球服务器云厂商资本开支持续高增长，市场对 AI 算力的需求也将持续增长，进而将带动 AI 服务器市场的高景气度延续，叠加人工智能的快速迭代和应用深化，也将驱动 PCB 产品性能向更高水平演进，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性 PCB 产品的需求将持续增长。

2025 年 PCB 行业复苏呈现显著的结构分化特征，尽管所有地区及细分领域均实现正增长，但高端赛道与核心应用领域增速领跑。从应用领域看，受益于数据中心、人工智能、物联网及汽车电子等领域的快速发展，高多层板、HDI 板、封装基板需求强劲增长，2025 年同比增速分别为 18.2%、25.6%、16.9%。从地域分布看，全球增长格局呈现中国引领、东南亚补充的态势，中国大陆作为全球最大 PCB 市场，占全球产值比重超过 50%，2025 年增长率将达到 19.8%。预计到 2025 年，全球 PCB 产值增长率约 15.4%，每个地区都实现正增长，2024 年-2029 年全球 PCB 产值年复合增长率约 8.2%，其中亚洲地区（除日本、中国大陆外）未来 PCB 产值复合增长高达 8.9%，是全球 PCB 产值增速最快的地区，越南、泰国等东南亚国家凭借政策优势与劳动力成本优势，成为产能转移核心承接地，形成国内 PCB 企业全球供应链双基地格局。尽管 PCB 行业面临原材料价格波动和贸易摩擦等挑战，但技术创新和市场扩展为行业带来了广阔的发展空间。未来，随着 AI 应用深化、新能源汽车渗透率提升及国产化替代推进，PCB 行业将从规模扩张向高质量发展转型，全球市场规模有望持续攀升。

### 2024-2029 年全球 PCB 产业发展情况预测（按地区）

单位：百万美元

地区	2023 年	2024 年	2025 年预测		2029 年预测	2024-2029 年复合增长率预测
	产值	产值	产值	增长率	产值	
美洲	3,206	3,493	3,791	8.5%	4,476	5.1%
欧洲	1,728	1,638	1,843	12.5%	2,040	4.5%
日本	6,078	5,840	6,166	5.6%	7,918	6.3%
中国大陆	37,794	41,213	49,354	19.8%	62,026	8.5%
亚洲（除中国大陆、日本）	20,710	21,381	23,737	11.0%	32,698	8.9%
总计	69,517	73,565	84,891	15.4%	109,158	8.2%

数据来源：Prismark2025 年 Q4 报告

2025 年，随着 AI 应用加速落地、云端运算与高速网通需求持续攀升，服务器与基础设施架构不断升级，产业竞争也逐步走向高技术门槛、高品质要求与高交付稳定度并重的新阶段。按照下游应用领域分类统计，服务器/数据存储是未来增长最快的应用领域，2025 年增长率将高达到 46.3%，2024 年-2029 年复合增长率将达到 18.7%。

## 2024-2029 全球 PCB 产值增长预测（按应用领域）

单位：百万美元

应用领域	2023 年	2024 年	2025 年预测		2029 年预测	2024-2029 复合增长率预测
	产值	产值	产值	增长率	产值	
计算机	9,391	9,429	10,100	7.1%	11,202	3.5%
服务器/数据存储	8,201	10,916	15,975	46.3%	25,729	18.7%
其他计算机	3,661	3,649	3,830	5.0%	4,110	2.4%
手机	13,085	13,886	14,793	6.5%	17,670	4.9%
有线基础设施	5,955	6,153	8,385	36.3%	12,759	15.7%
无线基础设施	3,118	3,177	3,611	13.7%	4,800	8.6%
其他消费电子	9,129	8,972	9,610	7.1%	10,755	3.7%
汽车	9,153	9,195	9,712	5.6%	11,365	4.3%
工控	2,871	2,918	3,157	8.2%	3,823	5.6%
医疗	1,440	1,500	1,603	6.9%	1,893	4.8%
军事/航空航天	3,514	3,770	4,116	9.2%	5,154	6.5%
合计	69,517	73,565	84,891	15.4%	109,258	8.2%

数据来源：Prismark2025 年 Q4 报告

受计算和通信基础设施热潮带动，高多层板和 HDI 成为增长最快的细分赛道，2025 年 HDI 市场预计实现 25.6% 的高增长，2025 年第二季度封装基板市场出现复苏迹象，2025 年增长率预测上调至 16.9%，这一增长态势由于 AI 服务器与高端网络设备对先进基板的持续攀升。从中长期看，AI 与高效能运算相关需求仍将维持高增长趋势，预计高多层板、HDI 板、封装基板等高端产品仍将保持相对较高的增速，2024 年-2029 年复合增长率分别为 9.0%、11.2%、9.8%。

2024-2029 年 PCB 市场产品结构变化（按产品类型）

单位：百万美元

产品类型	2023 年	2024 年	2025 年预测		2029 年预测	2024-2029 年复合增长率预测
			产值	增长率	产值	
高多层板	26,534	27,994	33,091	18.2%	43,106	9.0%
HDI	10,536	12,518	15,717	25.6%	21,295	11.2%
封装基板	12,498	12,602	14,727	16.9%	20,086	9.8%
软板	12,191	12,504	12,966	3.7%	15,144	3.9%
其他	7,757	7,947	8,390	5.6%	9,627	3.9%
总计	69,517	73,565	84,891	15.4%	109,258	8.2%

数据来源：Prismark2025 年 Q4 报告

### （三）主营业务分析

2025 年，是我们拥抱数字化与智能化变革时代浪潮、实现历史性跨越的一年。公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，紧扣“算力”主线，坚定聚焦通用服务器、AI 服务器、交换产品，以及加速卡等算力 PCB 市场，以技术创新驱动产品结构优化，通过数字化推动提产增效，经营业绩稳步提升，2025 年实现年营收 54.85 亿元，同比增长 46.89%，实现净利润 10.16 亿元，同比增长 50.24%。

（1）坚持聚焦算力应用，围绕战略目标，我们成功推动算力核心客户的认证流程，为后续深度合作奠定坚实基础。各部门紧密协同，全力配合客户完成审查流程并为量产订单转化积极做好各项准备。

（2）我们紧密跟随全球算力技术路线图，围绕新一代算力产品及工艺开展各项研发工作。在通用服务器领域，我们完成了 PCIe6.0 平台的转批量能力，在 AI 服务器领域，完成了 PCIe 交换板（30L+）、UBB/I/O 板（28L-46L）、OAM 板（18L+，2 阶-8 阶 HDI）、GPU 主板（24L6 阶 HDI）、中置背板（N+M/N+N 技术）等一系列高端产品的工艺能力认证，在数据中心交换机领域完成了 400G&800G 交换机板的量产。在工艺技术研发方面，在多孔对准度能力提升、6mm 厚板钻孔、30:1 高厚径比电镀、背钻对准度 D+4 及 stub 控制工艺等关键工艺能力取得突破，为进一步提升、优化产品结构打下坚实的基础。

(3) 广合科技坚持构建新质生产力，作为公司主力制造基地的广州广合，2025 年持续技改提升瓶颈工序的产能、工艺能力。不断提高广州广合的数字化程度，不仅实现了技术能力的提高也实现了产能的提升，产品结构不断优化，交付竞争力显著增强。报告期内，广州广合伴随营收规模提升的同时，保持了较高的盈利能力，不仅实现业绩指标的高速增长，同时各项运营效率指标健康。公司全资子公司黄石广合报告期内持续推动成本管控、调整产品结构、提产增效，报告期内实现扭亏为盈。泰国广合 2025 年 6 月正式投产，12 月实现月度盈利，盈亏平衡周期仅仅用了 6 个月，实现当年投产当年盈利。报告期内，泰国广合按原定计划完成了核心客户的审核认证，伴随着重点客户认证和产品导入，以及泰国工厂一期产能的释放，泰国广合正在成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎。

(4) 公司积极践行企业社会责任，将可持续发展理念深度融入企业战略与日常运营之中。在环境方面，公司持续加大节能减排力度，优化生产流程，降低资源消耗与污染物排放，致力于实现企业发展与环境保护的良性互动；在社会维度，关注员工成长与发展，注重供应链的可持续性，为社会的和谐稳定贡献力量；在公司治理层面，不断完善治理结构，提升决策透明度，加强风险管控，确保企业稳健发展。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	7,542,073,240.92	5,685,756,517.91	32.65%	3,812,432,088.78
归属于上市公司股东的净资产	3,978,084,998.00	3,073,845,894.57	29.42%	1,830,313,960.59
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	5,485,371,371.05	3,734,284,609.80	46.89%	2,678,270,258.07
归属于上市公司股东的净利润	1,015,789,038.65	676,100,402.24	50.24%	414,685,735.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	988,047,720.68	678,336,894.71	45.66%	435,316,714.63
经营活动产生的现金流量净额	1,031,570,638.39	796,284,627.37	29.55%	527,513,156.03
基本每股收益（元/股）	2.40	1.66	44.58%	1.09
稀释每股收益（元/股）	2.39	1.65	44.85%	1.09
加权平均净资产收益率	29.24%	25.87%	3.37%	25.60%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,116,984,677.76	1,307,768,753.13	1,410,375,593.28	1,650,242,346.88
归属于上市公司股东的净利润	240,371,973.05	251,211,378.52	232,236,211.98	291,969,475.10

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,759,130.84	244,794,091.51	225,984,674.90	284,509,823.43
经营活动产生的现金流量净额	210,792,975.60	242,309,634.53	306,449,229.52	272,018,798.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,764	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州臻蕴投资有限公司	境内非国有法人	40.14%	171,142,853	171,142,853	不适用	0	
深圳广谱投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.14%	43,249,099	43,249,099	不适用	0	
深圳广财投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.76%	28,832,734	28,832,734	不适用	0	
深圳广生投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.76%	28,832,734	28,832,734	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.70%	15,790,451	0	不适用	0	
长江证券创新投资（湖北）有限公司	境内非国有法人	2.47%	10,525,268	0	不适用	0	
广东粤科创业投资管理有限公司—广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.47%	6,277,223	0	不适用	0	
国投（广	其他	1.27%	5,423,221	0	不适用	0	

东) 创业投资管理 有限公司 — 国投 (广东) 科技成果转化 创业投资基金 合伙企业 (有限合 伙)						
柳嘉鸿	境内自然 人	1.25%	5,347,741	0	不适用	0
广东粤科 创业投资 管理有限 公司—广 东粤科汕 华创业投 资有限公 司	其他	0.98%	4,185,847	0	不适用	0
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有广州臻蕴投资有限公司 99.90%、0.10% 的股权； 2、肖红星为广生投资、广财投资的普通合伙人，分别持有广生投资、广财投资 10% 的出资份 额； 3、刘锦婵为广生投资、广财投资的有限合伙人，分别持有广生投资、广财投资 26.01%、 51.04% 的出资份额； 4、公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。					
参与融资融券业务股东 情况说明（如有）	股东柳嘉鸿通过普通证券账户持有 560,800 股，通过信用交易担保证券账户持有 4,786,941 股，实际合计持有 5,347,741 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

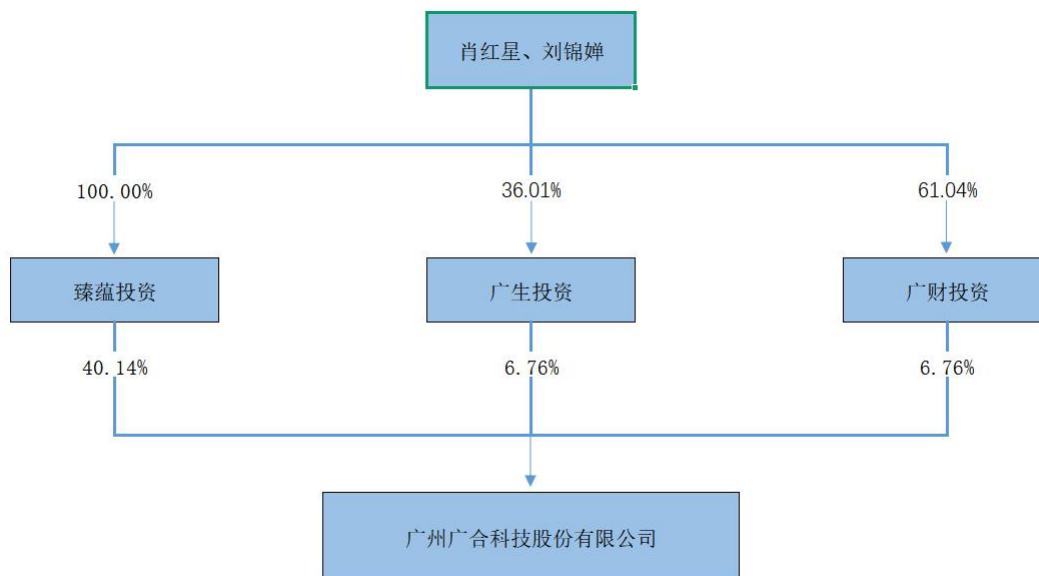
适用 不适用

**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

不适用。